



# tesa<sup>®</sup> HAF 8410 HS



## 제품 정보

60µm 황색 반응성 HAF 마운팅 테이프

## 제품 설명

tesa<sup>®</sup> HAF 8410은 페놀 수지와 니트릴 고무로 된 열활성 양면 황색 접착 필름입니다.

### 특성:

- 칩 모듈에의 안정적인 접착력
- PVC, ABS, PET, 폴리카보네이트 카드에 적합
- 일반적인 삽입 공정에서의 우수한 작업성
- 뛰어난 내노화성
- 고무 함량이 높아 제품 전기간에 걸쳐 유연성 유지

## 특성

- tesa HAF<sup>®</sup> 8410은 상온에서 끈적이지 않습니다.
- 본 제품의 접착력은 일정 시간 동안 가해지는 열과 압력에 의해 활성화됩니다.
- 신뢰할 수 있는 칩 모듈 본딩 \* PVC, ABS, PET 및 PC 카드에 적합
- 모든 일반 인플랜팅 라인에 대한 작업 용이성
- 뛰어난 내노화성
- 고무 함량이 높아 제품수명내내 유연성 제공

## Applications

tesa<sup>®</sup> HAF 8410은 스마트 카드에 칩 모듈을 삽입하는 용도로 설계된 제품입니다. 금속, 유리, 플라스틱, 목재, 섬유 등 모든 내열성 재료의 부착에도 적합한 제품입니다(클러치 용 마찰 라이너 등).

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### 제품 구조

- |          |              |       |       |
|----------|--------------|-------|-------|
| • 기재 소재  | 없음           | • 총두께 | 60 µm |
| • 접착제 종류 | 니트릴고무 / 페놀수지 | • 컬러  | amber |
| • 이형지 종류 | 글라신지         |       |       |

### 속성 / 성능 값

- 접착력 (동적 전단) 12 N/mm<sup>2</sup>

### 추가정보

Technical recommendations for Smart Card applications:

관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=08410>



# tesa<sup>®</sup> HAF 8410 HS

## 제품 정보

### 추가정보

tesa HAF<sup>®</sup> 8410 is not self adhesive. It is activated by heat and pressure over a certain interval. The following values are recommendations for machine parameters to start with. Please note that optimum parameters strongly depend on the type of machine, particular materials for card bodies and chip modules as well as customer requirements.

#### 1. Pre-lamination:

During pre-lamination, the adhesive tape is laminated onto the module belt. The pre-lamination step does not affect the shelf life time of the adhesive tape. Pre-laminated belts can be stored over the same period of time as the adhesive tape.

Machine setting:

- Temperature 120 – 140 °C
- Pressure 2 – 3 bar
- Time 2.5 m/min

#### 2. Module embedding:

During module embedding, the pre-laminated modules are cut from the module belt, positioned into the card cavity and permanently bonded to the card body by heat and pressure. Depending on the type of implanting line, single-step or multiple-step process are possible. Today, most implanting machines have multiple heat press steps.

Single-step process - machine setting:

- Temperature<sup>1</sup> 180 – 200 °C
- Pressure 65 – 75 N/module
- Time 1.5 s

Multiple-step process - machine setting:

- Temperature<sup>1</sup> 180 – 200 °C
- Pressure 65 – 75 N/module
- Time 2 x 0.7 s / 3 x 0.5 s

<sup>1</sup> Temperature measured inside the heating stamp. Different temperature settings recommended for different card materials:

PVC and ABS: 180 – 190 °C

PET and PC: 190 – 200 °C

Bonding strength values were obtained under standard laboratory conditions. Value is specification limit checked for each production batch (material: etched aluminum test specimen / bonding conditions: Temp. = 120 °C; pressure = 10 bar; time = 8 min). To reach maximum bonding strength, surfaces should be clean and dry.



# tesa<sup>®</sup> HAF 8410 HS

## 제품 정보

### 공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의 사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=08410>